

平成30年度 (公社)砥粒加工学会賛助会員会 シーズ・ニーズマッチング交流会
「企業紹介プレゼン」および「技術紹介パンフレット」のおすすめ

〔(公社)砥粒加工学会 賛助会員会 主催〕

◆**主旨**: 砥粒加工学会賛助会員会では、シーズ・ニーズマッチング交流会を開催いたします。今回は基調講演として「日本のモノづくりの課題: バリ取り、エッジ処理技術の現状および最新動向」と題したご講演をいただきます。その後、参加者に向け企業毎にシーズ情報をプレゼンしていただく機会を設けております。また企業紹介パンフレットを作成して、賛助会員企業のシーズ情報を発信していただけるようにしております。企業紹介プレゼン後には技術交流会(名刺交換会)を予定しておりますので、より活発な情報交換を行えると考えております。この機会に、貴社の技術を多くの参加者に直接アピールされることをお勧めいたします。

◆**日時**: 平成30年10月18日(木) 12時00分～19時15分 (11時30分 会場予定)

◆**場所**: 大田区産業プラザPio 6階D会議室

<https://www.pio-ota.net/>

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1丁目20-20

◆**交通手段**: <電車>京浜急行「京急蒲田」駅より徒歩約3分 JR京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅より徒歩約13分

◆**スケジュール**: 12:00～12:05 開催の挨拶

12:05～13:00 「日本のモノづくりの課題: バリ取り、エッジ処理技術の現状および最新動向」

講演者: 関西大学名誉教授 / バリ取り大学学長北嶋 弘一氏

13:10～14:50 企業紹介プレゼン

14:50～15:00 休憩

15:00～16:40 企業紹介プレゼン

16:40～17:00 名刺交換会

17:10～19:10 技術交流会

◆**参加費**: 5000円(技術交流会を含む)

◆**企業紹介プレゼン参加費**: 賛助会員企業: 無料

非賛助会員企業: 30,000円(賛助会員会に入会いただくと、今年度分の年会費として引当てます)

※企業紹介パンフレット(A4 1枚)投稿: 無料

◆**企業プレゼン**: 30社(先着順で定員になり次第締め切ります)、企業紹介パンフレットには上限はありません。

◆**申込締め切り**: 平成30年9月28日(金)

◆**申込および問合せ先**: (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 セラミックビル4F

TEL: 03-3362-4195 FAX: 03-3368-0902 E-mail: staff@jsat.or.jp

下記申込書にご記入の上、FAXまたはE-mailでお申し込み下さい。

FAX : 03-3368-0902 (公社)砥粒加工学会 事務局 行

E-mail: staff@jsat.or.jp 砥粒加工学会賛助会員会 企業紹介プレゼン参加申込書

住所			
勤務先・所属			
申込者氏名		会員資格	
TEL		FAX	
E-mail			
企業紹介プレゼン	参加 ・ 不参加	企業紹介パンフレット	投稿する ・ 投稿しない